

第1号議案

平成20年度事業報告書(案)

自:平成20年4月1日 至:平成21年3月31日

1. 全般

- (1) 学会の理念・ビジョンおよびコアコンピタンスに基づき、引き続き運營業務の効率化と透明性を高めることで学会活動の活性化と会員の増強につながる施策に取り組んだ。
- (2) 学会の継続的な発展と円滑な運営のため、「職員給与規程および職員退職金手当支給規程」の改訂を行うとともに、役員候補者選考基準に関する内規の制定、および技術委員会・研究会規程、表彰規程などの改訂を行い、会員サービスをさらに充実する学会運営基盤の整備をおこなった。
- (3) 本学会のプレゼンスを高め、国際交流活動を推進するため、IEEE CPMTの幹部ミーティングで、会長が本学会の活動を紹介し、ICEP共催での支援強化および本学会の活動紹介をCPMT学会誌に掲載依頼するなどコラボレーションを強化した。また、学会誌の解説記事・論文を韓国翻訳転載する契約を韓国雑誌社と契約し、アジア地域での国際交流活動も促進した。
- (4) 関西支部の活動として、若手研究者研究会を、支部独自の地域活動として積極的に展開した。九州地区では、第19回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(2009.9.10～11 福岡大学)の準備活動を開始した。
- (5) 当学会の更なる飛躍発展を期して、創立10周年記念式典を2008年11月13日に東京プリンスホテルにて開催した。

2. 国際会議・学術講演大会・展示会等の開催 (定款第4条第1号関係)

- (1) 国際会議「ICEP 2008」(組織委員長 株式会社東芝 浅井博紀氏)
2008.6.10～12、東京ビッグサイトにて、IEEE CPMT Japan Chapter および IMAPS と共催で、第12回の国際会議「ICEP 2008」を開催。海外27件(内、招待講演1件)を含む総計92件の論文発表と国際交流会を開催。論文集(A4判・523頁)を刊行。参加者246名(内、海外42名)。
- (2) 「2008 最先端実装技術シンポジウム・2008 マイクロエレクトロニクスショー」
2008.6.11～6.13、最先端実装技術シンポジウムとマイクロエレクトロニクスショー展示会を東京ビッグサイトにて開催。JPCA Show 2008(電子回路工業会主催)および JISSO PROTEC2008(ロボット工業会)と共同開催の相乗効果で、多くの参加者を集めた。
マイクロエレクトロニクスショーでは「最先端実装技術・パッケージング展」を開催。出展社は34社、99小間、来場者は延べ124,749人(登録者37,702名)。また「先端エレクトロニクスパビリオン」では部品内蔵基板についてポスター展示をおこなった。
最先端実装技術シンポジウムは、ベアチップ・KGD、部品内蔵基板、金属ナノ粒子応用実装、光回路実装、チップスタック、パッケージ用材料、高熱伝導材料、カーエレクトロニクス、MEMS 信頼性評価技術などの最先端実装技術に関して講演30件。聴講者572名。
- (3) 「第18回マイクロエレクトロニクスシンポジウム」(組織委員長 京都大学 池田教授)
2008.9.18～19、京都大学吉田キャンパスにて開催。講演91件(一般講演89件 招待講演2件)。
招待講演は「MEMSとナノテクノロジーのシームレス融合技術」(京都大学 田畑修教授)と「半導体ICと実装基板の融合に向けて—高密度・高性能実装技術の進むべき方向—」(NPO 法人サーキットネットワーク 本多進理事)。参加者513名。
- (4) 「第23回エレクトロニクス実装学会講演大会」(講演大会委員長 関東学院大学 本間英夫教授)
2009.3.11～13、関東学院大学金沢八景キャンパスにて開催。12件の招待講演、111件の一般講演の他に、今回から新たに、ものづくりセッション(30件)、ポスターセッション(25件)を行った。さらに、横浜 YJC および UVEC と共催で、学生・初学者向けのチュートリアルセッション(5件)も実施した。
特別講演は、「表面特性の温度スイッチを基盤とする細胞シート工学の創生」(東京女子医科大学・先端生命医科学研究所 岡野光夫教授・所長)、「宇宙探査活動のこれまでと近未来計画 ～月探査に要求されるナノテクノロジー～」(日本工業大学先端材料技術センター 三好和壽教授・センター長)。発表件数は多かったが、参加者数は不況の影響を受け607人にとどまった。

3. 調査・研究活動（定款第4条第2号関係）

(1) ワークショップの開催

①関西ワークショップ 2008 の開催

テーマを「実装技術・新しい展望への期待」として、コープ・イン・京都で2008.7.11に開催。特別講演は「MEMS の現状と将来」（東北大学／江刺正喜教授）、「大変革期を迎える半導体産業・パッケージング産業」（国際技術ジャーナリスト・セミコンポータル／津田建二編集長）。ポスター発表 19 件、参加者 90 名。

②2008 ワークショップ（修善寺）の開催

メインテーマを「商品価値を高める先進実装技術」、サブテーマを「ブレークスルーへの挑戦」として、ラフォーレ修善寺にて、2008.10.23～24、1泊2日で開催。招待講演は「IT 機器のハイパフォーマンスとCO₂削減の両立に向けたREAL IT COOL PROJECT」（日本電気株式会社 稲坂純氏）、「多機能三次元集積化技術の開発動向と今後の展望」（新エネルギー・産業技術総合開発機構 水野紘一氏）、「本にICタグを！2009 年－出版業界における導入の試みと大量実装技術への期待」（講談社 永井祥一氏）。ポスター発表 35 件、参加者 74 名。

(2) 技術委員会の開催行事

①材料技術委員会とシステムインテグレーション技術委員会の共同開催の公開研究会

(2008.12.8 国立オリンピック記念青少年総合センター)

テーマ「次世代インテリジェント実装材料」

講演 8 件、参加者 67 名。

②電磁特性技術委員会サマーセミナーの開催

(2008.8.26 国立オリンピック記念青少年総合センター)

テーマ「プリント配線板の誤動作を防ぐ！ 高速時代のパワーインテグリティ」

講演 9 件、参加者 193 名。

③信頼性解析技術委員会シンポジウム(2009.2.12 回路会館)

テーマ「高密度実装設計に要求される新しい信頼性技術」

講演 9 件、参加者 48 名。

(3) 公開研究会の開催

①システム実装CAE研究会(回路・実装設計技術委員会)

・第1回公開研究会(2008.5.30 東京ビッグサイト)

テーマ「チップ・パッケージ・ボード間協調設計のためのシミュレーション技術」

講演 5 件、参加者 102 名。

・第2回公開研究会(2008.12.12 回路会館)

テーマ「システム実装を支える設計・シミュレーション技術」サブタイトル:チップ・パッケージ・ボード間協調設計における性能評価および設計最適化技術

講演 5 件、参加者 57 名。

②超高速高周波エレクトロニクス実装研究会(電磁特性技術委員会)

・第1回公開研究会(2008.5.22 回路会館)

放射ノイズ低減、バランスフィルタ他に関する講演 8 件。参加者 43 名。

・第2回公開研究会(2008.8.1 マホロバマイズ三浦)

最新プリント配線板、デジタル回路の放射電磁界他に関する講演 8 件。参加者 56 名。

・第3回公開研究会(2008.11.7 回路会館)

ミリ波帯実装、フェライト薄膜、モーメント法他に関する講演 6 件。参加者 54 名。

・第4回公開研究会(2009.2.20 回路会館)

伝送路の減衰定数、広帯域フィルタ、テラヘルツ他に関する講演 8 件。参加者 31 名。

③マイクロ・ナノファブ리케이션研究会(配線板製造技術委員会)

・第4回公開研究会(2008.5.28 回路会館)

テーマ「高密度パッケージのマイクロ・ナノファブ리케이션技術」 講演 5 件、参加者 112 名。

- ・第 5 回公開研究会(2008.10.1 回路会館)
テーマ「プリントドエレクトロニクスを志向したマイクロ・ナノファブリケーション」
講演 5 件、参加者 117 名。
- ・第 6 回公開研究会(2008.12.17 回路会館)
テーマ「プリントドエレクトロニクスのマイクロ・ナノファブリケーション技術」
講演 5 件、参加者 89 名。
- ④EPADs研究会(配線板製造技術委員会)
 - ・第 1 回公開研究会(2008.7.16 回路会館)
テーマ「部品内蔵基板とその応用技術」 講演 5 件、参加者 95 名。
 - ・第 2 回公開研究会(2008.11.11 回路会館)
テーマ「部品内蔵基板とその応用技術Ⅱ」 講演 5 件、参加者 83 名。
 - ・第 3 回公開研究会(2009.2.16 回路会館)
テーマ「部品内蔵基板とこれを支える実装材料技術」 講演 6 件、参加者 70 名。
- ⑤次世代配線板研究会(配線板製造技術委員会)
 - ・第 1 回公開講演会(2008.7.9 回路会館)
テーマ「次世代配線板の姿を探る」 講演 5 件、参加者 118 名。
- ⑥先進実装技術研究会(電子部品・実装技術委員会)
 - ・第 1 回公開講演会(2008.7.22 回路会館)
テーマ「導電性接着剤」 講演 5 件、参加者 56 名。
 - ・第 2 回公開講演会(2009.2.2 横浜国立大学 教育文化ホール)
テーマ「接合を中心に新接合材料, 接合装置, 信頼性, 検査の動向」
横浜国大実装技術研究会と共催。 講演 6 件、参加者 67 名。
- ⑦電子部品研究会(電子部品・実装技術委員会)
 - ・第 1 回公開研究会(2008.11.17 回路会館)
テーマ「携帯電話用電子部品・実装技術動向」 講演 4 件、参加者 61 名。
- ⑧検査の立場からみた DFT 研究会(検査技術委員会)
 - ・第 1 回公開講演会(2008.7.14 回路会館)
5 社の事例発表、参加者 14 名。
- ⑨光回路実装技術研究会(光回路実装技術委員会)
 - ・第 35 回 OPT 公開研究会(2008.6.20 回路会館)
テーマ「光インターコネクション:材料から応用まで」 講演 4 件、参加者 50 名。
 - ・第 36 回 OPT 公開研究会(2008.10.9 回路会館)
テーマ「光インターコネクション普及に向けての提言」
ロードマップ WG の調査検討成果の公表。参加者 80 名。
 - ・第 37 回 OPT 公開研究会(2008.11.19 回路会館)
テーマ「省エネルギー化を実現する光実装技術」 講演 5 件、参加者 70 名。
 - ・第 38 回 OPT 公開研究会(2009.1.23 回路会館)
テーマ「光実装に求められる標準化」 講演 5 件、参加者 53 名。
- ⑩環境調和型実装技術研究会(環境調和型実装技術委員会)
 - ・第 1 回公開研究会(2008.6.13 東京ビッグサイト)
テーマ「環境調和技術の未来Ⅱ—新たに始まる環境ビジネス—」 講演 5 件、参加者 35 名。
 - ・第 2 回公開研究会(2009.1.20 回路会館)
テーマ「環境調和製品を支える実装技術」 講演 5 件、参加者 31 名。

4. 普及・啓発活動（定款第4条第3号関係）

(1) PWB 製造教育講座

①PWB 製造・初級コース(2008.5.29～30 回路会館)

新入社員、営業部門向けに広い技術分野にまたがるプリント配線板について、概要を主に修得することを目標とした教育講座を実施。受講者 29 名。

②PWB 製造・中級コース(2008.6.25～27 回路会館)

入社2～3年目の社員やプリント配線板のユーザーに基板の製造工程を修得することを目標とし副題を「要素技術講座」として、穴あけから仕上げ検査・メンテナンスまでの教育講座を実施。受講者 18 名。

③PWB 製造・上級コース(2008.7.31～8.1 回路会館)

入社4～5年目の社員向けにプリント配線板の製造品質不良対策や新規技術を修得することを目標とした教育講座を実施。受講者 29 名。

(2)実装技術教育講座

①実装技術入門講座(2008.5.15～16 回路会館)

営業マンや新入社員向けに配線板の材料と実装に適する回路設計、電子部品の種類と実装形態の変遷など基礎的なレベルの講義に、簡単な電子機器の組み立て、はんだ付けなどの実習を加えて「実装技術」を修得することを目標とした教育講座を実施。受講者 34 名。

②実装技術総合講座(2008.10.2～3 回路会館)

企業で実装技術に携わる中堅技術者やこれから実装技術にかかわる異分野の技術者を対象とした講座を実施。受講者 28 名。

③PWB 設計技能講習会—パターン設計の基礎(2008.11.20～21)

PWB 設計初心者向けにパターン設計の基礎から回路図記号の説明、部品の知識等を修得するための教育講座。これを受講してから次の技能検定受検者向け講習会を受講する。受講者 6 名。

④PWB 設計実技講習会—技能検定受検者向け講習会(2008.12.4～5)

PWB 設計(1・2級)技能の実技受検用の教育講座。作図練習を行うことで、合格圏内に到達することを目標とする講座。受講者 6 名。

(3) 先端技術セミナー

①第47回定例セミナー(2008.10.6 回路会館)

テーマ「半導体パッケージ・MEMS 開発動向」

基調講演は「More Than Moore 技術が切り開くエレクトロニクス産業の将来」((株)野村総合研究所 岸本隆正氏)。その他講演 6 件、参加者41名。

②第 48 回定例セミナー(2008.12.25 回路会館)

テーマ「車載エレクトロニクスの技術動向」

特別講演「世界の ECU 及びカーナビ実装技術の全貌」(セミコンサルト 上田弘孝氏)。その他講演 4 件、参加者40 名。

③第 49 回定例セミナー(2009.3.4 回路会館)

テーマ「モバイル機器を“Change”する最新実装技術」

基調講演は、「携帯機器における実装技術から学ぶ」(AiT 社 加藤凡典氏)。その他講演 4 件、参加者 27 名。

5. 情報収集および提供活動（定款第4条第4号関係）

(1) 「エレクトロニクス実装学会誌」の発行

- ①学会誌を7回発行(Vol.11 No.3～7 および Vol.12 No.1～2)。
- ②会員の技術・研究活動の成果として発表される研究論文、総合論文、速報論文、技術論文、解説等を学会誌に掲載し、エレクトロニクス実装の研究と技術に関する最新の情報を会員に提供した。

(2) 英文論文誌の発行

英文論文誌を2008.12に創刊した。

6. 内外機関等との交流・協力活動（定款第4条第5号関係）

(1) IMAPSとの連携強化

- ①IMAPSのAffiliate会員140名。
- ②WLC-ALC(World Liaison Committee-Asia Liaison Committee)を2008.6.11に開催し、アジア並びに欧米の委員との情報交換を行った。
- ③IEEE CPMTの幹部ミーティングで、会長が本学会の活動を紹介し、ICEP共催での支援強化および本学会の活動紹介をCPMT学会誌に掲載依頼するなどのコラボレーションを強化した。
- ④学会誌の解説記事・論文を韓国翻訳転載する契約を韓国雑誌社と契約し、アジア地域での国際交流活動も促進した。

(2) JPCA Show2008/JISSO PROTEC2008とのコラボレーション

例年、電子回路工業会と同時開催しているJPCA Show/マイクロエレクトロニクショーに、ロボット工業会のJISSO PROTEC展も加えて、3団体の同時開催展示会を2008.6.11～13、東京ビッグサイトにて開催した。また、最先端実装技術シンポジウムと公開研究会2件(環境調和型実装研究会、システム実装CAE研究会)を併設開催した。

(3) 関連学協会の各種事業に協賛など

1. 電子情報通信学会 環境電磁工学研究会と当学会の電磁特性技術委員会との共催“EMCJ研究会” 2008.7.17～18 機械振興会館
2. 日本能率協会“TECHNO-FRONTIER 2009” 2009.4.15～17 幕張メッセ(協賛)
3. 電気学会 “第25回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム” 2008.10.22～24 沖縄コンベンションセンタ (協賛)
4. 溶接学会マイクロ接合研究委員会 “Mate2009”2009.1.29～30 パシフィコ横浜 (協賛)
5. 電気学会 基礎・材料・共通部門 誘電・絶縁材料技術委員会 “基礎・材料フォーラム「プリント基板の試験と評価ーイオンマイグレーション現象とその対策」”2008.11.10 電気学会会館 (協賛)
6. 精密工学会 画像応用技術専門委員会 “動的画像処理実利用化ワークショップ 2009” 2009.3.5-6 日本大学工学部(福島県郡山市) (協賛)
7. 色材協会 第5回IT講座 2008.11.20～21 日大理工学部駿河台キャンパス (協賛)
8. 表面技術協会 みちのくフォーラム2008 2008.10.17～18 八戸地域地場産業振興センター (協賛)
9. 電気化学会 第73回半導体・集積回路技術シンポジウム 2009.7.9～10 東京農工大学小金井キャンパス (協賛)
10. (財)神奈川科学技術アカデミー KAST教育講座(コース名)高信頼性を実現するマイクロソルダリング技術 2008.11.27～12.4 かながわサイエンスパーク (後援)
11. 溶接学会マイクロ接合研究委員会と当学会の電子部品・実装技術委員会との共催 シンポジウム「電子システムインテグレーションにおける樹脂実装の現状と課題」 2008.10.28 芝浦工業大学 豊洲キャンパス
12. 日本印刷学会 2008E&S研究会セミナー“スクリーン印刷のフレキシブルエレクトロニクスへの応用” 2008.11.14 日本印刷学会 会議室 (協賛)
13. 日本時計学会 2008 秋季研究会 2008.8.30 中央大学理工学部 (協賛)

14. 応用物理学会 SSDM2009(国際固体素子・材料コンファレンス) 2009.10.6 仙台国際ホテル (協賛)
15. 電気学会 平成 21 年電子・情報・システム部門大会 2009.9.3~4 徳島大学工学部 (協賛)
16. NPO 法人サーキットネットワーク C-NET 定期講演会 2009.3.6 回路会館 (協賛)
17. エコデザイン学会連合、独立行政法人産業技術総合研究所 EcoDeSign2009 2009.12.7~9 ホテルロイトン札幌 (協賛)
18. (財)神奈川科学技術アカデミー KAST教育講座 めっき技術の最先端と新展開 2009.2.5,12,19のうち3日間 かながわサイエンスパーク (後援)
19. 日本能率協会 2009 熱設計・対策技術シンポジウム 2009.4.15~17 幕張メッセ国際会議場 (協賛)
20. 日本能率協会 2009 電子・機構部品 表面処理技術シンポジウム 2009.4.15~16 幕張メッセ国際会議場 (協賛)
21. 日本能率協会 2009 EMC・ノイズ対策技術シンポジウム 2009.4.15~16 幕張メッセ国際会議場 (協賛)
22. (財)神奈川科学技術アカデミー 第 3 回神奈川“環境調和型機能性表面”フォーラム 2009.3.16 KSP ホール (後援)
23. 電子情報通信学会 環境電磁工学研究会と当学会の電磁特性技術委員会との共催 EMCJ 研究会 2009.6.5 東京ビッグサイト
24. 電子情報通信学会 集積回路研究専門委員会 LSI とシステムのワークショップ 2009 2009.5.18~20 北九州市(協賛)
25. 電気学会 センサ・マイクロマシン部門 第 26 回「センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム」 2009.10.15~16 江戸川区タワーホール船堀(協賛)
26. 日本ゴム協会 第 45 回夏期講座“産業界におけるソフトマテリアル” 2009.7.9~10 名古屋国際会議場 (協賛)
27. 日本塑性加工学会 第 178 回塑性加工技術セミナー“塑性加工からアプローチするMEMS技術” 2009.7.27 大阪府立大学工学部 (協賛)
28. 日本溶接学会はんだ・微細接合部会と当学会電子部品実装技術委員会との共催 はんだ・微細接合部会シンポジウム 2009.6.26 飯田橋 家の光会館
29. 日本機械学会 講習会 構造解析のための有限要素法入門 2009.7.30 横浜国立大学総合研究棟 (協賛)
30. IMAPS/ACerS 共催 6th International Conference and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies 2010.4.19~21 幕張 OVTA (協賛)
31. 神奈川科学技術アカデミー KAST 教育講座一次世代研磨加工技術—2009.7.9~8.7 で 6 日間 かながわサイエンスパーク (後援)

7. 地域交流活動の促進（定款第4条第6号関係）

(1) 関西支部における各種事業の開催

①第8回若手研究会セミナー(2008.7.23 大阪大学中之島センター)

テーマ「伝熱解析の基礎と演習」講師:広島国際大学 大串教授 参加者 40名。

②第6回見学会/技術講演会(2008.11.7)

パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社鳥栖工場の見学

技術講演会 テーマ「車載 ECU 実装技術の進化」講師:セミコンサルト上田氏 参加者 31名。

③第9回若手研究会セミナー(2009.1.20、大阪大学中之島センター)

テーマ「銅粒子を用いた導電材料技術の現状」講演3件、参加者40名。

④第5回技術講演会(2009.2.27、大阪大学中之島センター)

テーマ「ものづくりを支える最新の実装技術動向」

2セッション:“MEMS”(講演3件)、“部品内蔵/接合技術”(講演4件) 参加者 53名。

(2) 九州支部における活動

MES2009 を福岡大学で開催するための準備を進めた。

8. 創立10周年記念行事

1998年4月に社団法人ハイブリッドマイクロエレクトロニクス協会と社団法人プリント回路学会が合併して創立されてから10年が経過したことを記念する式典を2008年11月13日に東京プリンスホテルにて、約160名の会員が集まり実施した。記念式典では来賓の経済産業省商務情報局電子情報機器課 課長補佐 月舘実様、および産業界を代表してシャープ株式会社執行役員 貫井孝様から祝辞をいただいた。また、創立10周年記念功労賞を歴代の会長・副会長に贈呈した。さらに独立行政法人科学技術振興機構理事長 北澤宏一様に「科学技術政策と企業、国民、政府の役割」という演題で、特別記念講演をいただいた。

*平成21年3月31日現在の会員数

正会員 2,907名(前年同期比 76名減)

学生会員 159名(前年同期比 19名増)

賛助会員 209社(前年同期比 10社減)